

請求の範囲

- [請求項1] 酸化セリウムを遊離砥粒として含み、ガラス基板の表面を研磨する研磨処理に用いる研磨液であって、
前記酸化セリウムについてレーザー回折・散乱法により求められる粒度分布において、小粒径側からの積算粒子体積が全粒子体積の $\times$ [%] に達するときの粒径を $D \times$ [μm] としたとき、
 $D 5$ は、 $1 \mu\text{m}$ 以下であり、
 $D 95$ と $D 5$ の差は、 $3 \mu\text{m}$ 以上である、ことを特徴とする研磨液。
- [請求項2] 前記 $D 95$ と $D 5$ の差は、 $4 \mu\text{m}$ 以上である、請求項1に記載の研磨液。
- [請求項3] 前記 $D 95$ は、 $7 \mu\text{m}$ 以下である、請求項1又は2に記載の研磨液。
- [請求項4] ブラシを用いてガラス基板の端面を研磨する研磨処理に用いる、請求項1～3のいずれか1項に記載の研磨液。
- [請求項5] 基板の表面を研磨する処理を含むガラス基板の製造方法であって、前記研磨は、請求項1～4のいずれか1項に記載の研磨液を用いて前記基板を研磨する処理である、ガラス基板の製造方法。
- [請求項6] 二酸化ケイ素の微粒子を遊離砥粒として含む研磨液を用いて前記基板の主表面を研磨する処理をさらに含む、請求項5に記載のガラス基板の製造方法。
- [請求項7] 前記ガラス基板は、磁気ディスク用ガラス基板である、請求項5又は6に記載のガラス基板の製造方法。
- [請求項8] 前記磁気ディスク用ガラス基板の外周の直径は、 94mm 以上である、請求項7に記載のガラス基板の製造方法。
- [請求項9] 請求項7又は8に記載のガラス基板の製造方法で得られた前記磁気ディスク用ガラス基板の主表面に少なくとも磁性層を形成する処理を含む、磁気ディスクの製造方法。